

深圳市景旺电子股份有限公司

关于部分募投项目建设完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次建设完成的募投项目：景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目（以下简称“新型电子元器件表面贴装生产项目”）。

● 项目承诺的募集资金投资金额使用情况：项目承诺募集资金投资额 6,803.95 万元，截至 2019 年 7 月 31 日累计使用金额 6,777.70 万元，差异金额 26.25 万元为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,000,000.00股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除发行费用人民币59,711,880.00元，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。上述募集资金于2016年12月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了天职业字[2016]17352号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资额 (万元)	募集资金承诺 投资金额(万元)	项目实施 进度
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	74,120.68	74,120.68	建设完成
2	景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	6,803.95	6,803.95	建设完成

3	偿还银行贷款及补充流动资金	25,000.00	24,272.18	实施完毕
合计		105,924.63	105,196.81	

二、本次建设完成的募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，新型电子元器件表面贴装生产项目由子公司景旺电子科技（龙川）有限公司具体实施，建设期三年，边建设边投产，建设期第一年部分投产，预计第四年达产。为尽快解决 SMT 产能不足，公司于 2016 年开始以自筹资金启动建设，由于募集资金实际到位时间晚于计划，新型电子元器件表面贴装生产项目建设进度有所延缓，公司于 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，决定延长该项目建设期至 2019 年 8 月底。

截至本公告日，新型电子元器件表面贴装生产项目已经建设完成，达到了预定的可使用状态。项目承诺募集资金投资额 6,803.95 万元，截至 2019 年 7 月 31 日已经累计投入 6,777.70 万元，差异金额 26.25 万元为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

三、本次建设完成的募投项目的募集资金专户余额使用计划

截至 2019 年 7 月 31 日，该项目募集资金专户余额 137.91 万元（含利息），公司仍然实行募集资金专户管理，后续将按照项目合同约定的付款进度安排支付。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日